

深圳市德明利技术股份有限公司

关于调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1120号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币26.54元，募集资金总额为人民币530,800,000.00元，扣除与发行有关费用（不含增值税）人民币74,907,641.51元，实际募集资金净额为人民币455,892,358.49元。

募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年6月28日出具的大信验字[2022]第5-00010号《验资报告》予以验证。

2、拟调整项目募集资金使用和结余情况

截至2023年11月30日，公司“3D NAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目”具体投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金已投入金额	项目投资进度
3D NAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目	16,196.89	10,648.25	65.74%
SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目	17,392.35	12,531.60	72.05%

二、本次部分募投项目变更的具体情况及其原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露内容：

“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”拟投入资金 29,941.88 万元人民币，本项目将在公司现有系列移动存储主控芯片的基础上，通过继承或优化原有自主研发 IP，设计高效的 CPU 子系统，研发先进工艺制程的高性能低功耗的 3D NAND 闪存主控 SOC 芯片，并对移动存储模组解决方案进行技术升级，突破该领域关键核心技术，提升核心竞争力，推动公司移动存储模组产品的技术迭代，完善移动存储主控芯片和模组产品技术研发创新体系，保障公司在细分领域的市场领先地位。2022 年 7 月 1 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，公司募集资金净额为 45,589.24 万元人民币，公司承诺在该项目投入募集资金 16,196.89 万元人民币。截至 2023 年 11 月 30 日，公司已投入募集资金 10,648.25 万元，该项目承诺投入募集资金已使用 65.74%；

“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”拟投入资金 32,151.82 万元人民币，本项目将在公司现有系列存储主控芯片及产业化应用方案的基础上，通过设计高效的 CPU 子系统，优化数据流编解码 IP，完成先进工艺制程的 SSD 主控 SOC 芯片设计，继承并优化原有其它 IP 并进行整合、验证及投片，并对产业化应用方案进行技术升级，推动 SSD 模组产品的技术迭代，完善 SSD 主控芯片和模组产品技术研发创新体系，以满足市场及客户快速增长的订单需求，提升公司的盈利能力，达成公司战略规划。2022 年 7 月 1 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，公司募集资金净额为 45,589.24 万元人民币，公司承诺在该项目投入募集资金 17,392.35 万元人民币。截至 2023 年 11 月 30 日，公司已投入募集资金 12,531.60 万元，该项目承诺投入募集资金已全部使用 72.05%。

（二）调整募投项目投资总额和内部投资结构的原因

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额为 45,589.24 万元，远少于《首次公开发行股票招股说明书》中原计划的项目投入资金总额，而募集资金不足部分则需公司使用自有资金进行补足。公司结合自身经营情况、

战略发展的规划与布局，以及未来经营资金使用的需求和资金使用效率，对该项目进行持续评估，以股东利益最大化为目标。若按照原披露的计划对上述两个募投项目继续进行投入建设，则会一定程度上影响公司的日常运营，增加公司的经营风险，不利于公司长远发展和长期战略计划与目标的实现，不符合公司及股东的整体利益。

因此，为保障募投项目的顺利实施，公司将根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”进行适当调整。

（三）调整募投项目投资总额和内部投资结构的具体情况

公司对募投项目的投资总额和内部投资结构调整的具体情况如下：

1、“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”投资总额及内部投资结构调整如下：

单位：万元

序号	投资内容	调整前	调整后
		总投资	总投资
1	软硬件投资	19,666.26	9,606.75
2	研发支出	4,801.03	6,340.70
3	基本预备费	983.31	0.00
4	铺底流动资金	4,491.28	0.00
5	场地投入	0.00	1,089.08
合计		29,941.88	17,036.54

2、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”投资总额及内部投资结构调整如下：

单位：万元

序号	投资内容	调整前	调整后
		总投资	总投资
1	软硬件投资	22,137.33	9,007.86
2	研发支出	4,084.85	8,339.77

3	基本预备费	1,106.87	0.00
4	铺底流动资金	4,822.77	0.00
5	场地投入	0.00	1,149.60
合计		32,151.82	18,497.24

注：部分数据尾数差异为四舍五入结果。

三、相关审议程序

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

1、董事会意见

董事会同意公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”投资总额及投资内部结构进行适当调整。

2、监事会意见

监事会同意公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”投资总额及内部投资结构进行适当调整。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”及“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”募集资金投资总额和内部投资结构，是基于募集资金的实际到位情况、公司生产经营状况、资金状况的综合考量等作出的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》

的规定，符合公司现实情况和发展规划，不会对公司生产经营和业务发展造成障碍，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、保荐人意见

经核查，保荐人认为：

公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

保荐人对公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的事项无异议。相关议案尚需公司股东大会审议通过。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年12月8日